



VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、CONEXPO-CON/AGG 2020において、厳しい環境下における安全な運用を可能にする VIA Mobile360 AI 掘削安全キットを公開

2020年3月12日 台湾・新北市 / 米ネバダ州ラスベガス – VIA Technologies, Inc.は、現地時間の3月10日～14日に米ネバダ州ラスベガスで開催されている建築・土木関連機器や技術に関する大型展示会 CONEXPO-CON/AGG 2020において、採石場や鉱山、建設現場における事故や機器の損傷リスクを低減する VIA Mobile360 AI 掘削安全キットを公開いたしました。



本製品の主な特徴は以下のとおり。

- ・世界でもっとも危険な採石場、鉱山、建設現場における衝突や機器の損傷リスクを軽減
- ・カメラ AI と短距離超音波およびミリ波センサー・テクノロジーの多用な組み合わせにより、車両オペレーターの状況認識を強化
- ・豊富な視覚データ表示とカスタマイズ可能なアラートにより、車両の運転者の安全性と利便性を向上
- ・すべてのタイプおよびサイズの車両向けの柔軟なカスタマイズオプション

VIA Mobile360 AI 掘削安全キットは、最先端のカメラ AI、超音波近接センサーおよびミリ波短距離レーダーセンサー技術をサポートすることにより、もっとも過酷で危険な環境下においてもオペレーターの状況認識を高めます。また、スマート・センサー・フェュージョンを利用することにより、本キットをあらゆる形またはサイズの車両や機器で厳しい要件のビジュアル認識および障害物検出アプリケーションの実効を可能にします。その主な機能は次のとおりです。

VIA、CONEXPO-CON/AGG 2020において、厳しい環境下における安全な運用を可能にする VIA Mobile360 AI 掘削安全キットを公開

2/3

- ・4 台の FOV-190° Gen-Lock カメラと VIA Mobile360 SVS テクノロジーを使用した、リアルタイム 360° 周囲環境ビデオ
- ・リア FOV-190° カメラと CAN バスを使用した動的な移動体検出
- ・最大 3 台の FOV-40° 車載グレードカメラと VIA Mobile360 ADAS テクノロジーを使用した死角検知と前面衝突検知
- ・VIA Mobile360 センステクノロジーを使用した超音波近接センサーとミリ波短距離レーダーセンサーのサポート
- ・カスタマイズされたアラートと豊富な視覚データ表示をサポートする統合インターフェース

「最先端のビジョンと短距離レーダーセンサー技術により、VIA Mobile360 AI 掘削安全キットは、オペレーターが世界でもっとも厳しい地形において、より安全に重機や機器を操作することを可能にします」と、VIA Technologies, Inc.の国際マーケティング担当 VP リチャードブラウンは述べています。「柔軟なカメラと短距離センサー技術の融合により、本キットは、もっとも要求の厳しいアプリケーションや昼夜あらゆる条件における動作を最適化することができます」

VIA Mobile360 AI マイニングセーフティキット@ CONEXPO-CON / AGG 2020

VIA Mobile360 AI 掘削安全キットは、ラスベガスコンベンションセンター ブロンズホールの #B90725 にある CONEXPO-CON/AGG の VIA ブースで公開中です。そのハードウェア的特徴は次のとおりです。

- ・ファンレスで堅牢な VIA Mobile360 M820 車載システム
- ・FOV-190° Gen-Lock フレームステンチカメラ
- ・ADAS 用 FOV-40° 車載グレードカメラ
- ・二重構造のすぐれた耐久性を持つ筐体
- ・内部および外部振動パッド
- ・ヒートシンクの強化
- ・IP65 準拠のケーブルグランド
- ・IP69K 準拠のカメラ
- ・オプションの超音波近接センサー
- ・オプションのミリ波短距離レーダーセンサー
- ・IP67 準拠 10.1 インチ産業グレード LCD ディスプレイ

VIA Mobile360 AI マイニングセーフティキットの詳細については、下記 URL をご参照ください。

<http://www.viatech.com/en/products/ai-systems/mobile360-mining-kit/>

また、VIA の CONEXPO-CON/AGG 2020 出展内容に関する詳細は、こちらからご覧いただけます：

<https://www.viatech.com/en/about/events-2020/conexpo-2020/>

本製品に関する画像は、下記 URL からダウンロードできます。

<https://www.viagallery.com/mining-kit/>

VIA、CONEXPO-CON/AGG 2020において、厳しい環境下における 安全な運用を可能にする VIA Mobile360 AI 挖削安全キットを公開

3/3

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、交通、産業およびスマートシティアプリケーション向けの革新的なスマートソリューションを通じ、ビジネスを高度な AI、IoT、コンピュータービジョンテクノロジーに接続するための国際的なリーダーです。台湾・台北に本社を置く VIA のグローバルネットワークは、米国、アジア、ヨーロッパのハイテクセンターとリンクし、世界をリードするハイテク、産業、運輸会社の多くを含む顧客に広がっています。

<http://www.viatech.com/>

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。